2023年度　工学部セメスター派遣プログラム　申請書

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フリガナ | (セイ) | | | (メイ) | | | 写真 |
| 氏名 | ( 姓 ) | | | ( 名 ) | | |
| 氏名 (ローマ字) | (※パスポートの表記又はパスポート申請予定の表記と同様) | | | | | |
| 住所 | 〒　　　- | | | | | |  |
| 所属 | 工学部 | 学科 | 年 | | 学籍番号 | 教員名（自署） | |
| 連絡先 | 携帯電話：  E-mail（大学付与メールアドレス）： | | | | | | |
| 出身高校 |  | | | | | | |
| 語学力 | ※証明書添付のこと  TOEFL(iBT・PBT・ITP)・TOEIC・IELTS・英検 点・級  ※いずれかに○をしてください。 ( 年 月 日時点) | | | | | | |
| 希望順位等 | |  |  | | --- | --- | | 大学名 | 希望インターンシップ先企業（TUMは除く）2社 | | 第一希望 |  | | 第二希望 |  | | 第三希望 |  | | | | | | | |
| 希望する  研究テーマ | キーワードのみ： | | | | | | |
| 国籍\* | (外国籍の場合、永住許可：有・無) | | | | | | |
| 奨学金受給状況 | 現在受給している奨学金：　有・無  （有を選択した場合）　奨学金名称：  　　　　　　　　　　　　　　併給：　可・否　　　月額　　　　　　円 | | | | | | |
| 保護者の 同意 | 上記申請者が、東京農工大学セメスター派遣プログラムに参加することに同意します。  年　　　月　　　日　　　　　　　保護者氏名： (自署) | | | | | | |

\*奨学金要件確認、ビザ要件確認のため使用

◆留学プロポーザル◆

|  |
| --- |
| ●志望動機  ●自己PR  ●将来の計画、グローバル活動への抱負等  ●派遣先大学で行いたい研究、学びたいこと等  研究キーワード（英語で）＞  ●希望するインターンシップ先企業・団体へどのようにアプローチしていくか  　（希望する国ごとに記載） |

**◆締　切：2023年1月27日(金)16:30厳守**

◆提出先：工学部　学生支援室　教務係　[窓口持参]または[郵送]により提出